

CR ハイスクールオブザデッド (高尾)

【TXE】 確率=1/319.6 確変=・初 50.0%・継続 100.0%(リミット8回)(転落 1/319.6)

電サポ=通常後/100回 賞球=4&1&3&4&15

【TLC】 確率=1/217.7 確変=・初 50.0%・継続 100.0%(リミット8回)(転落 1/144.9)

電サポ=通常後/100回 賞球=4&1&3&4&10

- 機種タイプ...V 確転落リミット機
- 潜伏確変仕様...なし
- 通常時保留メモリー...4個
- 保留消化...電チュー優先
- ラウンド変動...あり
- 小当り...あり
- 特賞...右打ち

【MAX 出玉】

【TXE】(15個/10C)

- ・3R...420個
- ・4R...560個
- ・5R...700個
- ・6R...840個

【TLC】(10個/10C)

- ・3R...270個
- ・4R...360個
- ・5R...450個
- ・6R...540個

サブデジメモリー
メインメモリー

■遊技盤の仕様■

<アクリルパネル>

【玉軌道シミュレーション】

<参考盤面傾斜= 分 厘>

【設置確認項目】(新台)

- ①番号確認(遊技盤・枠・主基板)
- ②主基板(かしめ・封印シール)
- ③払出基板(ケース破損・開封)
- ④その他基板(破損・開封・コネクタ)
- ⑤遊技釘・風車(本数・形状・材質)
- ⑥発射装置(実発射にて確認)
- ⑦払出装置(実入賞の払出にて確認)
- ⑧図柄作動確認(液晶・メイン・サブ)

【点検確認】(部品)

- | | |
|--|--|
| <p>A: 製造番号・番号票の点検
1:遊技盤番・2:枠・3:主基板</p> <p>B: 主基板等の点検
4:主基板のケース異常・開封
5:主基板の形状異常・異物
6:払出基板のケース異常・開封
7:払出基板の形状異常・異物
8:ロムの形状・装着異常</p> <p>C: 形状異常・異物の点検
9:周辺基板・10:中継端子板
11:外部端子板・13:コネクタ
12:ユニット接続端子板・14:配線
15:裏バック・16:遊技くぎ及び風車
17:上下皿</p> | <p>D: 発射装置の点検(確認)
18:タッチセンサー作動確認
19:発射個数・20:球飛び位置</p> <p>E: 遊技基本動作の点検(確認)
21:入賞賞球数・22:最大入賞数
23:役物作動・24:図柄表示作動</p> <p>F: その他の点検
25:全ての接続箇所点検
26:スピーカーの作動確認
27:各種ランプの点灯確認</p> |
|--|--|